

Das Löten im Herstellungsprozess einer Leiterplatte

Mark Wolf
22.11.06

Gruppe I
Bedienung und Logik

Handout

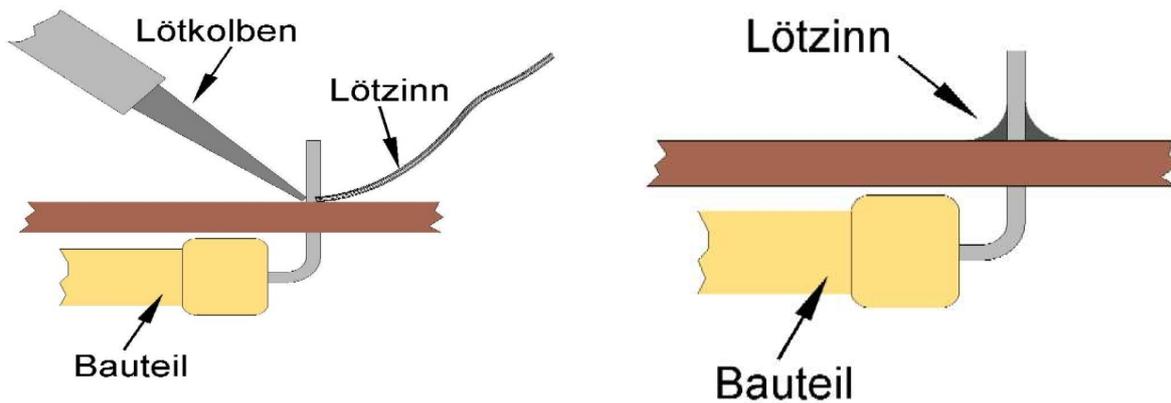
Begriffe zum Vortrag

Allgemein:

ESD	Electrostatic discharge (elektrostatische Entladung)
FED	Fachverband für Design, Leiterplatten- und Elektronikfertigung
PBB	polybromiertes Biphenyl
PBDE	polybromiertes Diphenylether
RoHS	Restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment (Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten)
SMD	Surface Mounted Device (Bauelement zur Oberflächenmontage)
SMT	Surface Mounted Technology (Oberflächenmontage)
THD	Through Hole Devices (bedrahtete Bauelemente)

Elemente:

Ag	Silber
Au	Gold
Bi	Wismuth
Cu	Kupfer
In	Indium
Ni	Nickel
Pb	Blei
Sn	Zinn



Beispiel für das Lötten eines bedrahteten Bauelements

Reihenfolge beim Lötten

1. Lötstelle erwärmen (Pad und Bauteil gleichzeitig)
2. Lot zuführen (auf richtige Menge achten)
3. ca. 1s warten (Flussmittel verdampfen lassen)
4. LötKolben absetzen
5. Lötstelle erstarren lassen (ohne Bauteile zu bewegen)

Häufige Fehlerursachen beim Lötten

